



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen.
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
P 136	8	38	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

P 136

Modular-Einbaukupplung, 8p8c (RJ45), mit Vollschirmung, stehende Ausführung, mit Flansch, für Leiterplatten, im Tablett

1. Werkstoffe

Kontaktträger	PE GF, V0 nach UL 94
Kontakt	CuSn, unternickelt und selektiv vergoldet
Lötkontakt	CuSn, unternickelt und verzinkt
Schirmung	CuZn, vernickelt

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	Modularstecker P 129
-------------------	----------------------

3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	35 mΩ
Strombelastbarkeit	2 A max.
Betriebsspannung	250 V
Isolationswiderstand	5 · 10 ⁸ Ω

P 136

Modular chassis socket, 8p8c (RJ45), with full shielding, upright version, with flange, for printed circuit boards, in tray

1. Materials

Body	PE GF, V0 acc. to UL 94
Contact	CuSn, pre-nickelated and selectively gilded
Solder contact	CuSn, pre-nickelated and tinned
Shielding	CuZn, nickelated

2. Mechanical data

Mating with	modular plug P 129
-------------	--------------------

P 136

Embase femelle modulaire, 8p8c (RJ45), avec blindage total, version droite, avec collet, pour cartes imprimées, en tableau

1. Matériaux

Corps isolant	PE GF, V0 suivant UL 94
Contact	CuSn, sous-nickelé et doré sélectivement
Contact à souder	CuSn, sous-nickelé et étamé
Blindage	CuZn, nickelé

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	connecteur modulaire mâle P 129
-------------------	---------------------------------